

2012年3月期 第2四半期 決算説明資料



Tera Probe

<http://www.teraprobe.com/>

2012年3月期第2四半期業績説明

今回の発表の概要

上期実績

<メモリ事業>

2Qにおいてテスト時間の長い製品の受託量が1Q比減少するなど、生産MIXの悪化があったものの、売上高、営業利益ともおおむね予想通りの結果となった。

<システムLSI事業>

当社グループの主要受託製品が組み込まれている最終製品の市場環境の悪化と、新規受託予定の製品の立ち上がりの遅れも影響し、売上高、営業利益とも予想を下回る結果となった。

通期見込み

10月よりWLP事業を行うテラミクロスが連結対象になることが売上高にはプラス要因となるが既存のテスト受託では主要顧客の生産調整による悪影響が3Qも継続する可能性が高く、テスト時間の長い製品の回復にも時間がかかると見込まれることから、売上高、営業利益の予想を変更する。

なお、テラミクロス買収に伴うのれんの影響は暫定的に織り込んでいないため、今後変更が生じる可能性がある。

2011年度上期 実績

(億円)

		上期実績			四半期実績		
		1H/FY2010	1H/FY2011	YoY増減	1Q/FY2011	2Q/FY2011	QoQ増減
	メモリ	93.6	102.5	10%	54.1	48.4	-11%
	システムLSI	8.7	10.5	21%	5.4	5.1	-6%
	その他	-0.0	-0.2	—	0.1	-0.3	—
売上高		102.2	112.8	10%	59.7	53.1	-11%
	メモリ	33.6	27.7	-18%	17.2	10.5	-39%
	システムLSI	-4.4	-3.6	—	-1.4	-2.2	—
	その他	-5.0	-5.7	—	-2.8	-2.9	—
営業利益		24.1	18.5	-23%	13.0	5.5	-58%
営業利益率		24%	16%		22%	10%	
当期純利益		16.0	9.7	-39%	7.1	2.6	-63%
当期純利益率		16%	9%		12%	5%	

上期実績増減分析(売上高)

上期実績(YoY)

<メモリ事業>

・テスト時間の長いメモリ製品の比率増加等により9億円増

<システムLSI事業>

・イメージセンサの増加、アナログ製品の新規受託開始等により2億円増

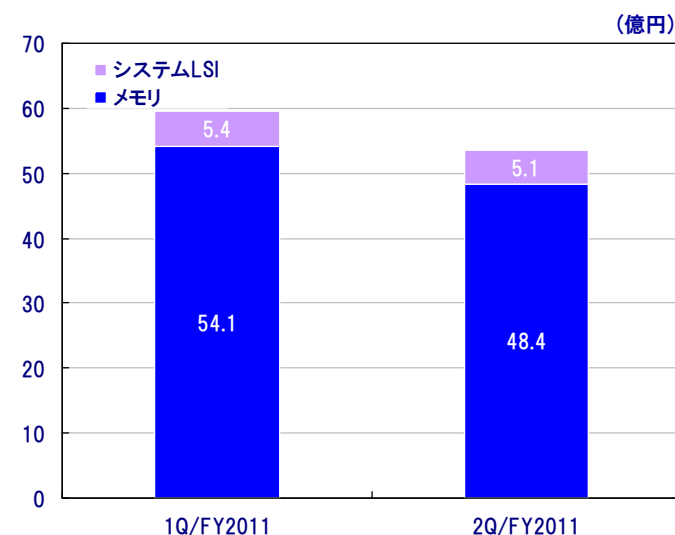
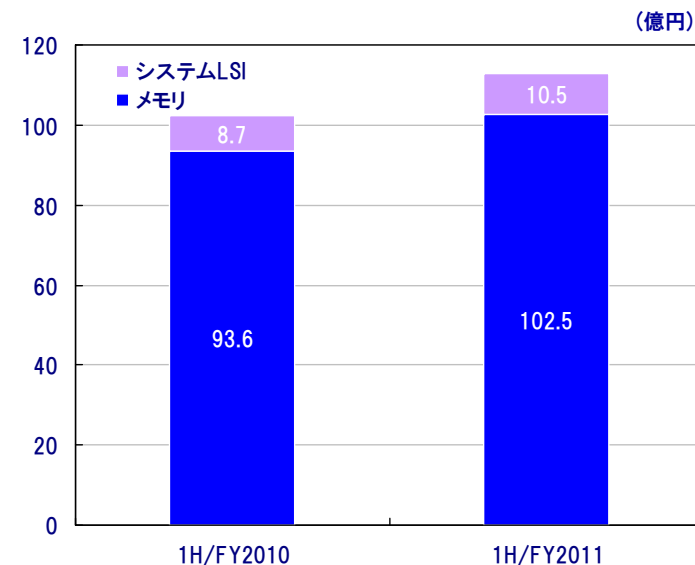
2Q実績(QoQ)

<メモリ事業>

・テスト時間の長いメモリ製品の比率減少等により6億円減

<システムLSI事業>

・ロジック製品のうちデジタル家電向け減少等により0.4億円減



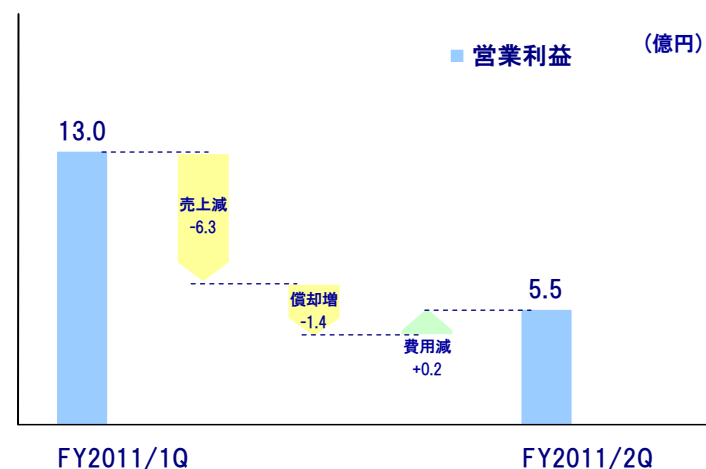
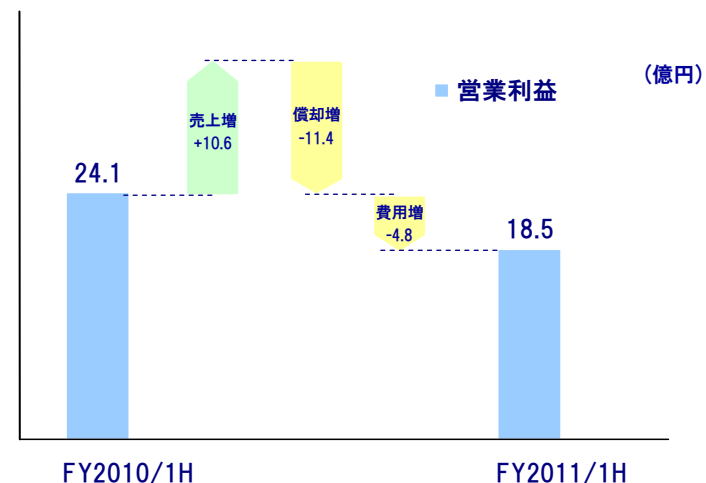
上期実績増減分析(営業利益)

上期実績(YoY)

- ・テスト時間の長いメモリ製品の比率増加等により売上10億円増
- ・前年度の設備投資による償却費増加等により費用16億円増

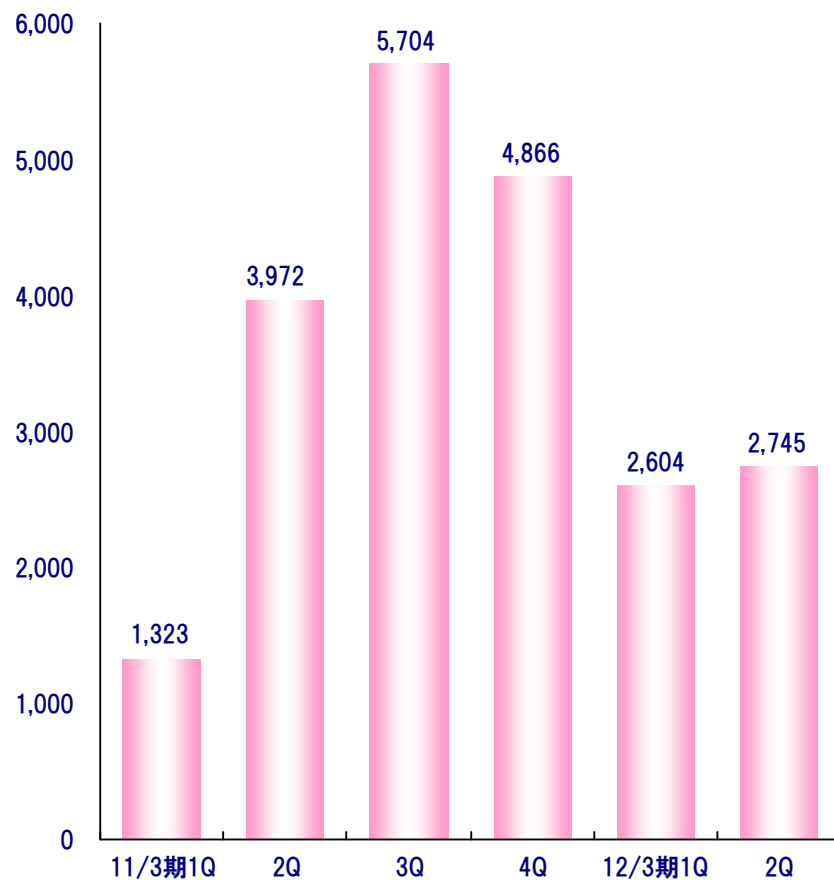
2Q実績(QoQ)

- ・テスト時間の長いメモリ製品の比率減少等により売上6億円減
- ・新規受託品対応等のための償却費増等により費用1億円増

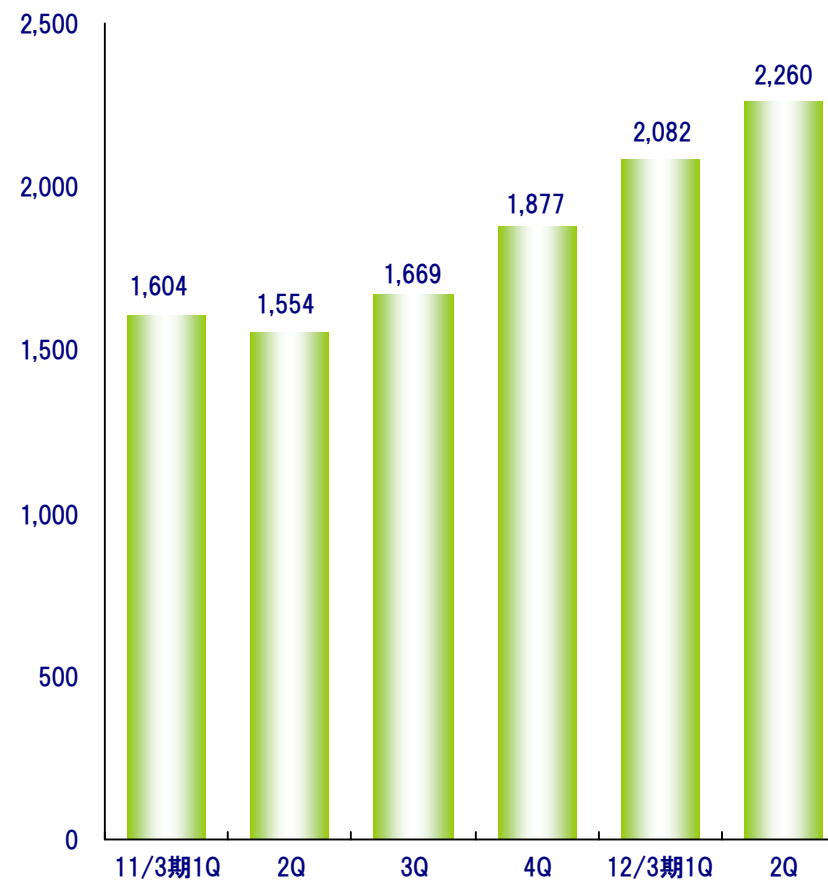


設備投資及び減価償却

設備投資額推移



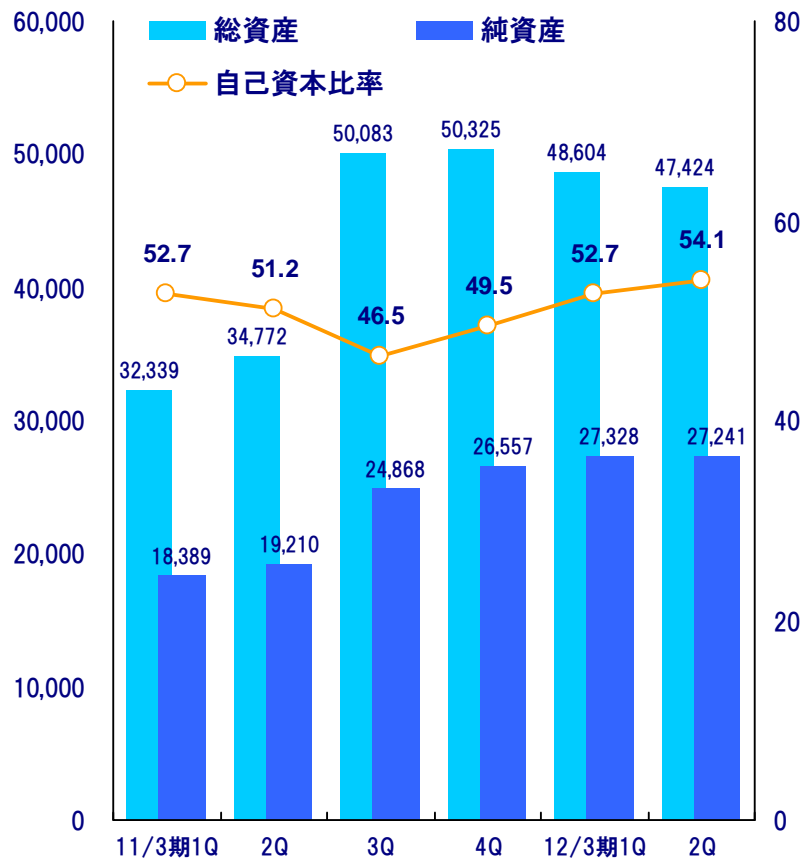
減価償却費推移



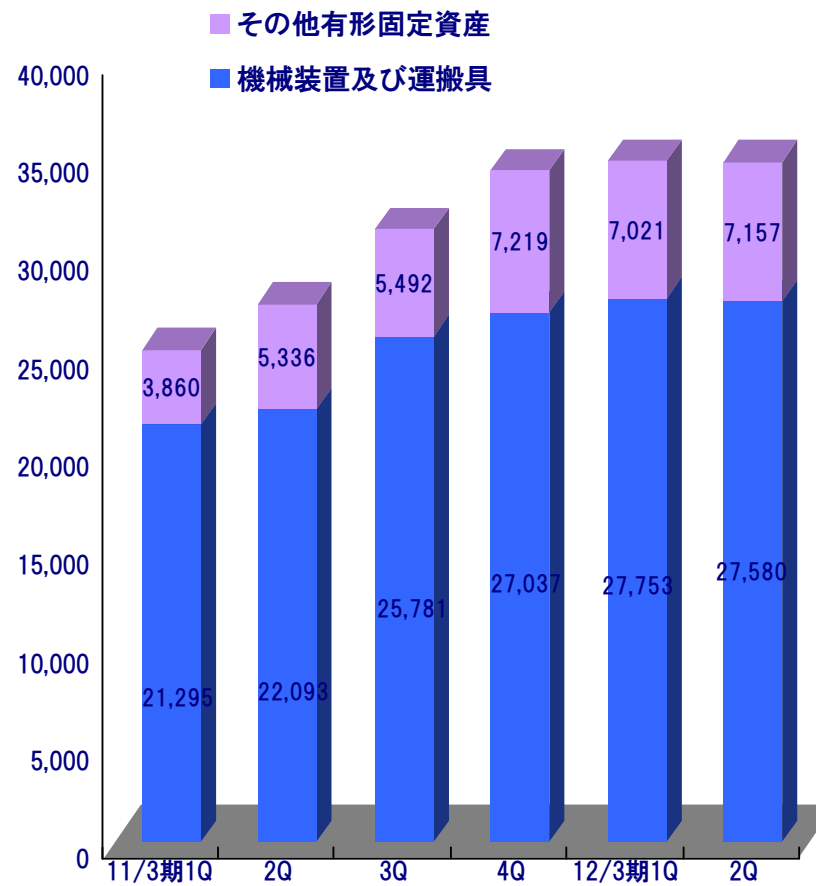
単位:百万円

財務状況①

総資産・純資産・自己資本比率



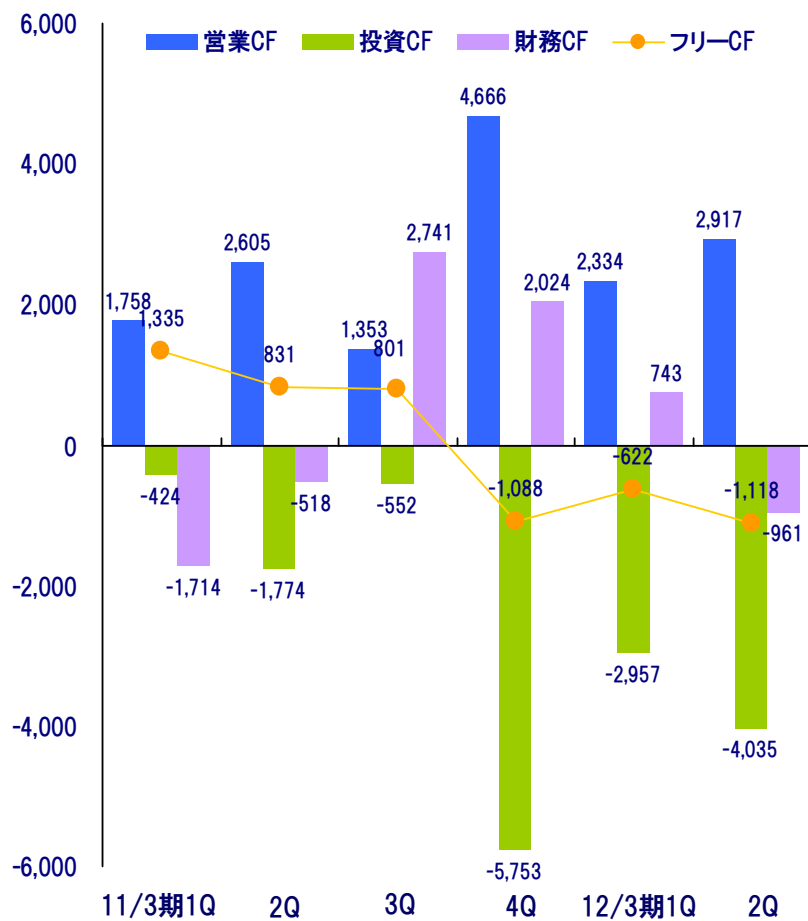
有形固定資産の推移



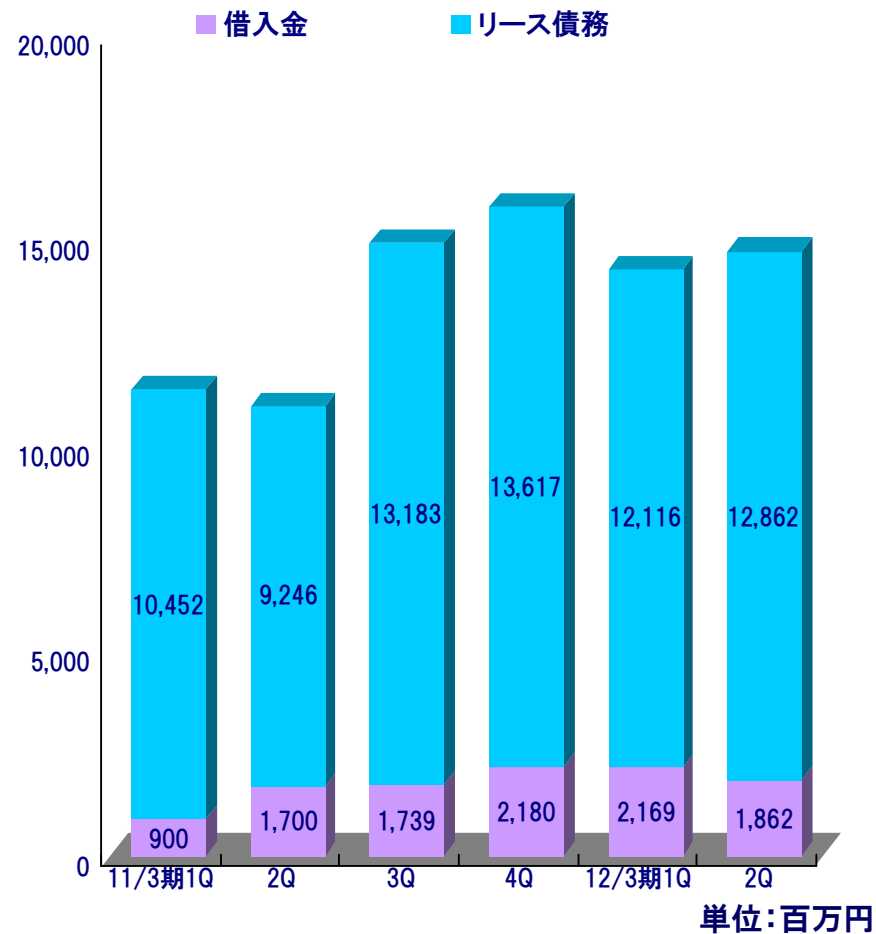
単位:百万円

財務状況②

キャッシュ・フロー



借入金・リース債務残高



2012年3月期業績予想

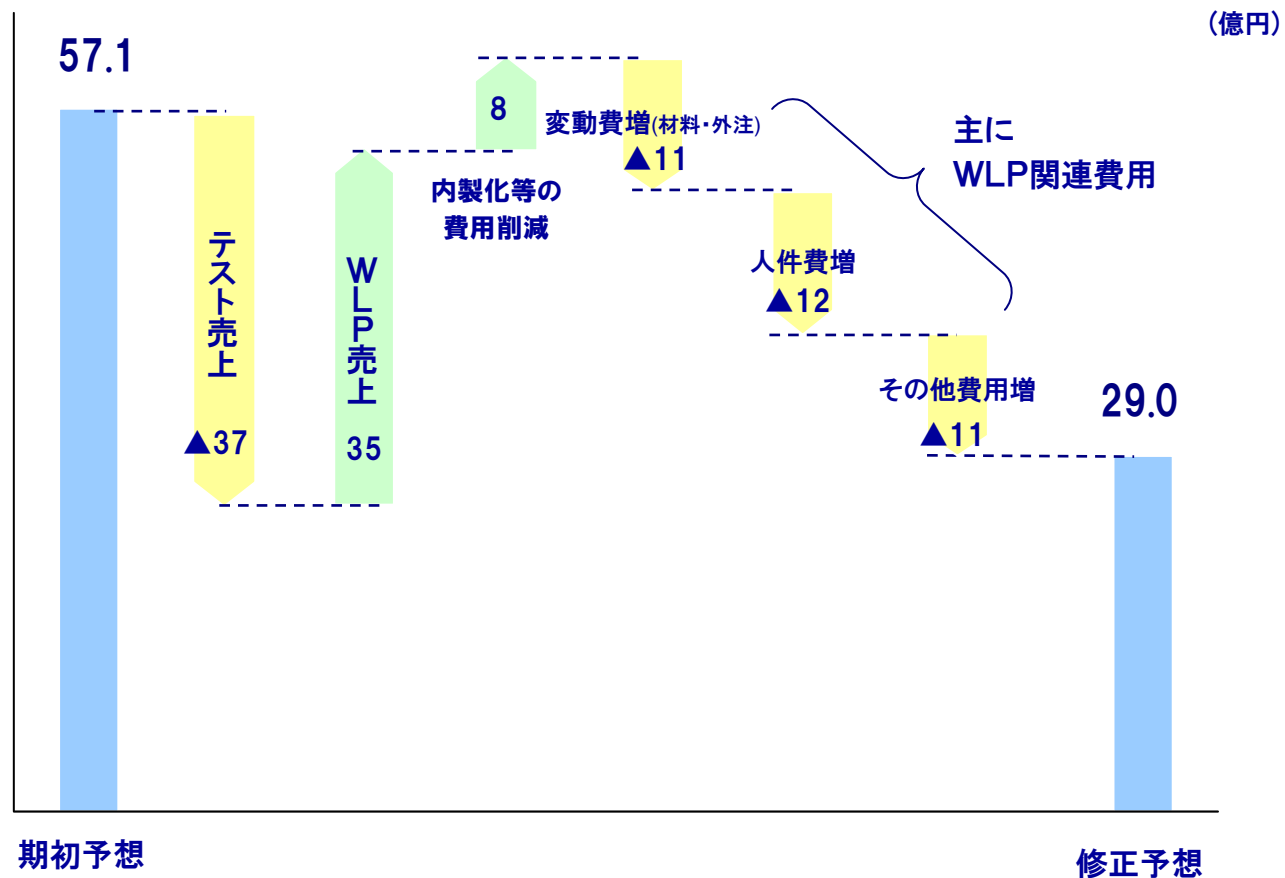
2011年度業績予想

(億円)

	FY2010実績	FY2011期初	FY2011修正	修正増減		YoY増減
売上高	213.8	255.0	253.0	-2.0	-0.8%	18%
営業利益	51.8	57.1	29.0	-28.1	-49.2%	-197%
営業利益率	24%	22%	11%			
当期純利益	41.5	30.9	14.0	-16.9	-54.7%	-221%
当期純利益率	19%	12%	6%			
設備投資	158.6	120.0	84.0	-36.0	-30.0%	-47.0%
減価償却	67.0	91.0	93.5	2.5	2.7%	39.5%

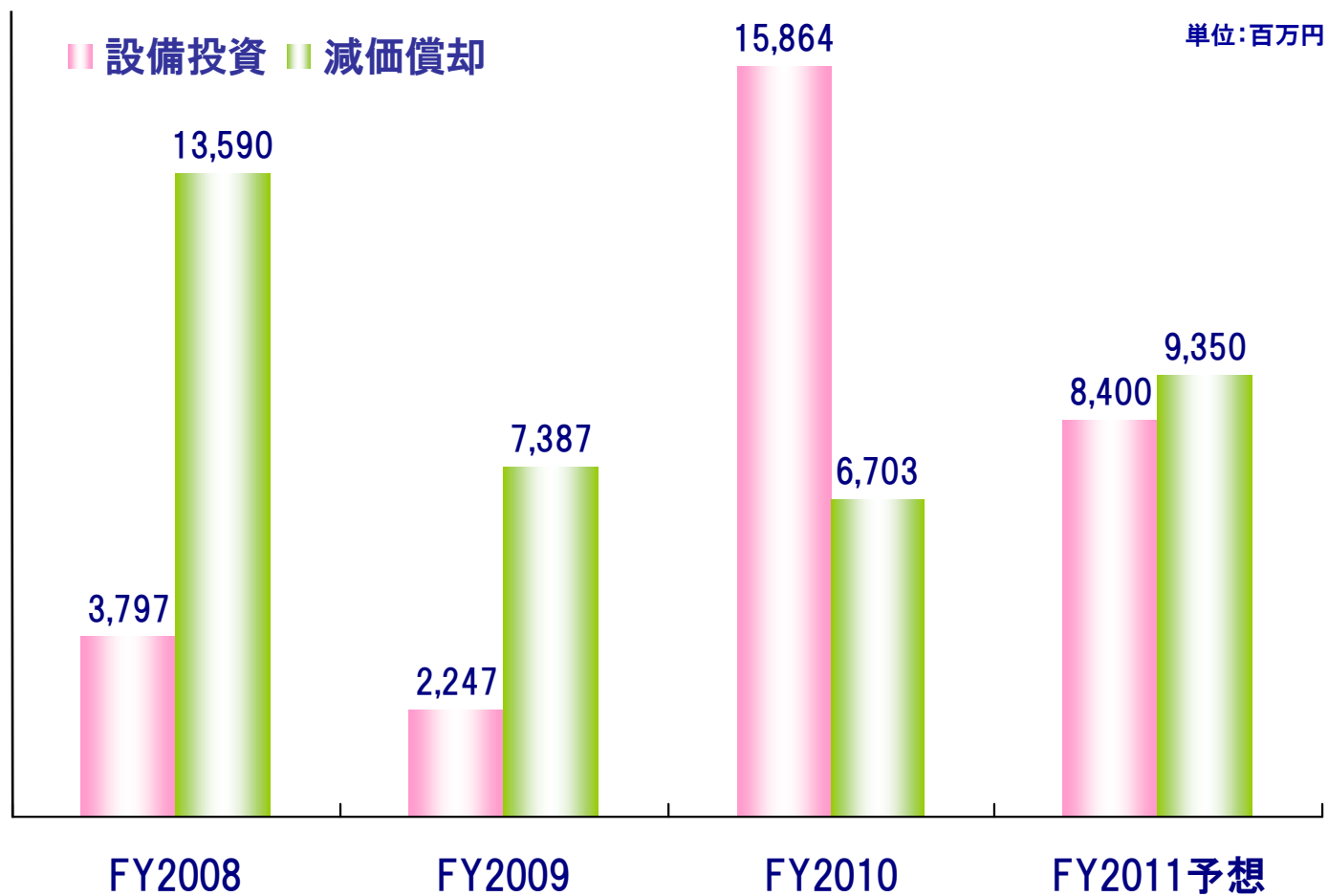
通期予想増減分析(営業利益)

通期予想(期初予想比較)



設備投資及び減価償却推移

投資及び償却推移(修正後)



第3四半期以降の予定・見通し

- テラミクロスの連結子会社化によりWLP事業開始
 - ・ テラプローブグループによるターンキーサービスの提供
- メモリ事業ではその他メモリ製品のファイナルテスト新規受託
- システムLSI事業ではアナログ製品、パワーIC製品の取り組みを強化

(株)テラミクロスについて

(株)テラミクロス会社概要

社 名	株式会社 テラミクロス (英文名称:Teramikros, Inc.)
本 社 所 在 地	東京都青梅市今井三丁目10番地の6
代 表 者	代表取締役社長 越丸 茂
設 立	2011年7月
事 業 内 容	半導体パッケージング事業 ＜ウエハ・レベル・パッケージ(WLP)事業＞
資 本 金	300,500千円
従 業 員 数	300名(2011年10月1日現在)

本資料における注意事項等

- 本資料は投資家の参考に資するよう、株式会社テラプローブ(以下、弊社)の現状を理解していただくために作成したものです。
- 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢及び弊社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。
- 投資を行う際は、必ず弊社が作成する「平成24年3月期第2四半期決算短信」をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断において行っていただきますよう、お願いいたします。

【本資料及び当社IRに関するお問い合わせ先】

株式会社テラプローブ
コーポレートプランニング・IR部門
TEL (045)476-5711
URL <http://www.teraprobe.com>